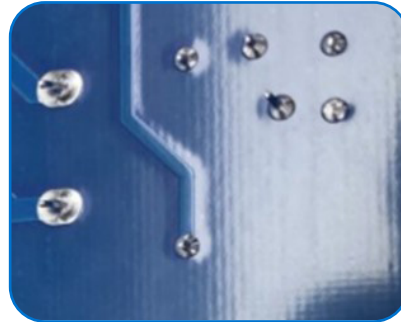


ALPHA[®] EF-6038HF

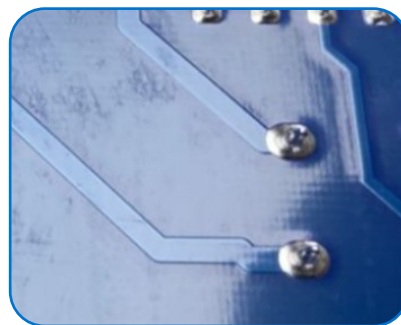
超低残留, 无卤素, 免清洗波峰焊助焊剂

ALPHA EF-6038HF是极低残留、无卤素、醇基型液态助焊剂, 专为标准至中等复杂程度的印刷电路板组装而设计, 适用于对工艺窗口和可重复性有严格要求的场合。其宽广的工艺窗口、良好的热稳定性和抗氧化性有助于在产线条件波动的情况下也能保持波峰焊接性能的一致性。

这种不含松香的配方具有出色的可靠性性能和良好的通孔填充效果, 同时几乎不会留下任何残留物, 直接降低了焊后处理的风险, 并且无需额外清洁即可确保出色的引脚测试性能。可预测的通孔焊接结果可减少后续制程波动, 确保生产过程始终受控。



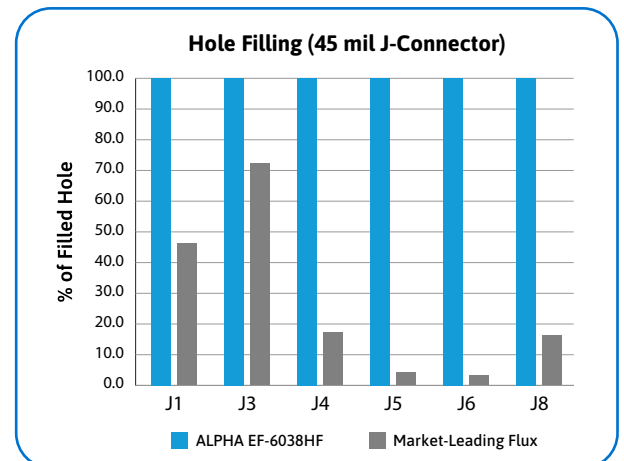
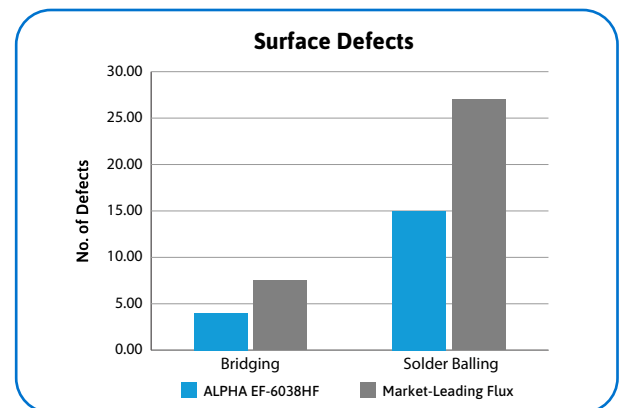
ALPHA EF-6038HF
残留极少且无粘性,
确保探针测试可靠。



常规低固含量助焊剂

关键特性

- 极低且无粘性助焊剂残留带来出色的线路板外观效果, 并且对引脚测试几乎无干扰
- 工艺窗口宽使得助焊剂能够在各种装配条件下灵活应用
- 出色的通孔填充效果能显著提高电气可靠性和机械强度
- 热稳定性好的助焊剂活化剂配方能够减少焊接缺陷, 并确保焊接效果的一致性
- 通过IPC J-STD-004 A/B SIR确保了终端组件的长期电气稳定性。
- 无卤素配方适用于高可靠性组装及环保应用



ALPHA[®] EF-6038HF

超低残留, 无卤素, 免清洗波峰焊助焊剂

技术规格

参数	规格
固态含量(wt%)	3.4%
比重	0.815 - 0.855
酸值 (mg KOH/g flux)	29 (Typical)
无卤素	Yes
IPC 助焊剂分类	ORL0 per J-STD 004 ORM0 per J-STD 004B

卤素状态

标准	要求	测试方法	状态
IEC 61249-2-21	焊接后残留物(阻燃剂)中的溴或氯含量分别低于<900 ppm 或总量低于 <1500 ppm	TM EN 14582 根据 IPC TM 2.3.34 萃取固态物质	合格
JEDEC “低卤素”电子材料定义指导	焊接后残留物(阻燃剂)中的溴或氯含量低于 <1000 ppm		合格

制程参数

操作参数	推荐值
助焊剂应用	喷洒
焊接应用	波峰焊
板上表面预热温度	105 - 130 °C (221 - 266 °F)
板下表面预热温度	比上表面高 0 - 25 °C (0 - 45 °F)
焊炉温度	260 - 280 °C (500 - 536 °F)
波峰接触时间	2 - 7.5s (3 - 5s 最常见)

上述指导数据都已被证明能产生优异的结果。但是, 由于设备、元件和电路板的差异, 适合您的最佳设置可能有所不同。为了优化您的工艺, 我们建议您进行实验设计, 以优化最重要的变量(如助焊剂使用量、传送带速度、上表面预热温度、焊炉温度和电路板方向等)。

